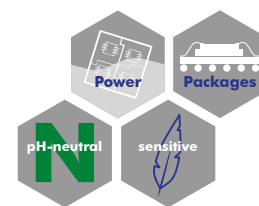


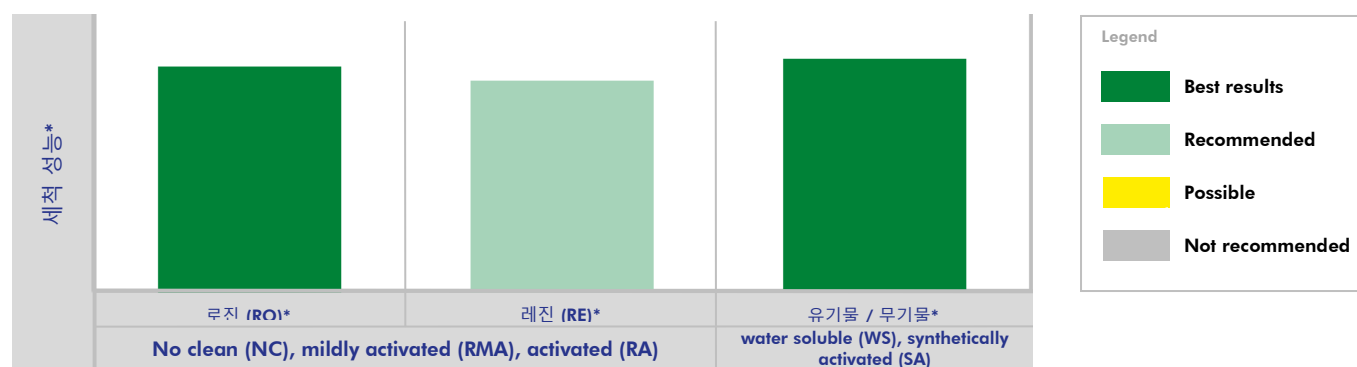
HYDRON® SE 220

반도체 부품 세척을 위한 pH 중성 세척제



HYDRON® SE 220은 딥탱크 공정을 위해 특별히 개발된 수계 기반 단상 세척제입니다. HYDRON® SE 220은 다이 부착 후 플립칩이나 CMOS 뿐만 아니라 리드프레임, 개별 부품, 파워 모듈, 파워 LED 등 모든 종류의 반도체 전자 제품의 플럭스를 제거합니다. 단상(single-phase) 구조이기 때문에 용액이 분리되지 않아 우수한 세척과 린스 과정을 거쳐 와이어 본딩이나 몰딩 같은 후속 공정을 위한 최적의 표면을 제공합니다. 또한 HYDRON® SE 220은 pH 중성 용액으로 우수한 물질 호환성을 보장합니다.

적용 범위 - 반도체 부품 디플럭싱(Defluxing)



* J-STD-004

다른 세척제와 비교 시 이점

- 단상 구조로 분리되지 않아 쉽게 처리될 수 있고 딥탱크 공정에서 뛰어난 세척 성능을 보입니다.
- 잔사 없이 DI-water로 쉽게 린스 가능합니다.
- pH 중성이기 때문에 패시베이션과 같은 물질에 대해 우수한 호환성을 보입니다.
- HYDRON® SE 220은 와이어 본딩, 몰딩 및 접착제 본딩과 같은 후공정을 위해 활성화된 구리 표면을 제공하며, 활성화 된 표면은 일정 기간 동안 유지됩니다.
- HYDRON® SE 220은 인화점이 없고 냄새가 약해서 방폭 장치가 없는 딥탱크 장비에서 적용 가능합니다.

공정 단계

세척 공정	부품	1. 세척	2. 린스	3. 건조
초음파 (US) / 침전 스프레이 방식 (SUI)	파워 모듈, 리드프레임, 개별 소자, 파워 LED, 플립칩, CMOS	HYDRON® SE 220	DI-water ¹	Hot air

¹ DI-water의 온도는 20-40°C/68-104°F를 권장합니다.